

HC-860C

半透明状

特征与优点:

- ◆优越的弹性和良好的粘接强度。
- ◆极速固化，绝缘减震。
- ◆可粘接大多数通用材料。

典型应用:

- ◆PCBA上的电子原器件粘接与固定。
- ◆塑胶件之间的粘接。
- ◆五金，玻璃、陶瓷的粘接
- ◆密封防水的应用



包装与储存:



注:

- 1、本文所载是我公司认为可靠的资料，该产品说明中的数据都为非标准值。记载的内容，产品性能改良，产品规格等在没有预告的情况下可能会有所变更。
- 2、我公司只对产品是否符合规格给予保证，在使用时，一定要先进行测试，确认适合您使用目的产品。
- 3、我公司的硅酮制品是面向一般工业用途而开发。超过贮存期，经检验合格仍可使用。

HC-860C的主要性能		
序号	检验项目	技术要求
(No.)	(Items)	(Technique Request)
1	反应类型	醇型
2	外观 (Exterior)	透明，膏状
3	表干时间 (Tack free time min)	3~10
4	完全固化时间 (hours)	8~24
5	比重 (Specific gravity)	1.1~1.2
固化后的物理特性 (7天23℃ / 50%RH)		
6	硬度 (Hardness Shore A)	30~40
7	抗拉强度 (Tensile strength MPa)	≥ 2
8	剪切强度 (Adhesive strength MPa)	≥ 1
9	伸长率 (Elongation %)	200~300
10	体积电阻率 (Volume resistivity $\Omega \cdot \text{cm}$)	$\geq 1 \times 10^{14}$
11	击穿电压 (Strength of breakdown voltage kV/mm)	20~22
12	介电常数 (Dielectric constant 60Hz)	3

使用方法:

使用前，按用量需求大小，剪开尖嘴端部，挤出即可，室温固化。表面硫化速度与空气中的相对湿度和温度有关：温度越高，硫化速度越快，反之越慢。